1. **公司基本資料：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司** | 景碩科技股份有限公司 | | | **電話** | 03-5571799 | | | **產業** | 半導體IC載板 |
| **地址** | 1.石磊廠：桃園市新屋區中華路1245號  2.清華廠：桃園市新屋區中華路810號  3.新豐廠：新竹縣新豐鄉建興路二段526號  4.幼獅廠：桃園市楊梅區高獅路580號 | | | | | | | **網址** | http://www.kinsus.com.tw |
| **景碩FB** | https://www.facebook.com/kinsus.tw/ |
| **聯絡人** | IDL招募Team | **電話** | 03-5571799  03-4871919 | | | **Email** | recruit@kinsus.com.tw | | |

1. **公司招募訊息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★**公司介紹** | | 景碩科技成立於民國89年9月，為一股票上市公司，主要股東為和碩集團，目前員工人數逾6000人，主要從事IC封裝用之基板研發、製造與銷售，自設立以來秉持「滿足客戶、追求卓越」的理念，朝向技術引導市場的研發方向，以技術、產品超越競爭者來提高獲利，掌握趨勢研發新世代產品為目標。 台灣的半導體產業除了擁有核心優勢的人才、技術外，最重要的是要構建完整的產業供應鏈，隨著近年來IC封裝逐漸為BGA、CSP，甚至是Flip-Chip所取代，成為封裝主流的趨勢下，景碩科技在封裝載板研發及製造技術上的投注，已成為技術領先的優勢，其中包含細線路、薄厚度、複雜結構等技術，另外結合對市場發展及需求的敏銳觸角，逐漸形成領先同業的優勢能力，景碩科技期許能夠成為領先全球的世界級載板製造商。 除了擁有堅強的研發及專業製造技術團隊之外，景碩科技也具備完善的福利制度，我們深信「唯有人才，永不折舊！」，透過完整、系統化的訓練與發展架構，發揮每位員工的潛能，重視每位員工在職場及生涯的規劃與發展，期許讓員工職涯及生活品質能夠同步提升，我們竭誠歡迎各類專門技術人才及管理人才共同加入，一同參與公司之經營與成長！ |
| **實習階段** | ★薪資 | □時薪：\_\_\_\_\_\_\_ █月薪：40,000元以上(加班費另計) □其他： |
| ★實習時間 | 每週一至週五，共40小時。 |
| ★保險 | █勞保 █健保 █其他保險：團保 |
| ★膳宿 | █膳食補助：40元/餐\_█住宿補助(付費提供)：1,200-2,000元□交通補助 |
| 其他福利 |  |
| ★給實習生的招募說明 | | **加入景碩您有以下的學習體驗及福利:**   1. 專業培訓課程，產業工作實務經驗 2. 了解半導體IC載板相關製程 3. 依出勤班制比例發放季獎金 4. 符合資格者可申請獎助學金(學士20-35萬；碩士25-40萬) 5. 入職滿三個月即與正職員工一般的福利(旅遊津貼、春節/三節/生日禮券等) 6. 工作餐補助，廠內亦有提供7-11便利商店 7. 食衣住行育樂完備福利，提供健檢、專業按摩、專業健身房、球場等 |

**產業實習企業申請表**

1. **實習條件申請表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務1** | **實習職務2** | **實習職務3** |
| ★職務名稱 | 製造工程師 | 製程工程師 | 設備工程師 |
| ★部門(或產線) | 製造部門 | 製程部門 | 設備部門 |
| ★地點(或廠區) | 新竹新豐廠/桃園新屋廠 | 新竹新豐廠/桃園新屋廠 | 桃園新屋廠 |
| ★實習  內容描述 | 1.生產產品品質管控及交期管理訓練  2.製程不良率及報廢之改善訓練  3.設備生產SOP流程說明  4.生產作業規範制定及流程訓練  5.6S工作環境介紹及安全維護說明  6.急單生產運作及作業處理訓練 | 1.製程參數測試及驗證訓練  2.製程能力及管制規格制訂訓練  3.製程能力提升測試學習 | 1.設備機台原理及分析故障原因訓練  2.設備機台維修實作  3.降低零件庫存經驗分享  4.設備日常巡檢訓練 |
| ★實習期間  (可複選) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) |
| ★所需人數 | 30人 | 4人 | 6人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少：\_40\_\_\_時  (或)每周至少：5天 | 每周至少：\_\_40\_\_時  (或)每周至少：5天 | 每周至少：\_\_40\_\_時  (或)每周至少：5天 |
| 希望校/系 | 機械／電機／機電／電子／輪機／造船或其他「理工相關背景」 | 機械／電機／機電／電子／輪機／造船或其他「理工相關背景」 | 機械工程相關, 電機電子工程相關 |
| 英文能力 | □略懂 🗹中等 □精通 | □略懂 🗹中等 □精通 | □略懂 ☑中等 □精通 |
| 其他需要  檢附之資料 | 🗹履歷🗹成績證明 □其他： | 🗹履歷 🗹成績證明 □其他： | ☑履歷 ☑成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 🗹期待後續留任 □待評估 | □僅為階段支援 🗹期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ☑期待後續留任 □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | 🞎提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  🗹長期性職缺(不限時) | 🞎提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  🗹長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  ☑長期性職缺(不限時) |

**實習條件申請表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務4** | **實習職務5** | **實習職務6** |
| ★職務名稱 | 製程整合工程師 | 工業工程師 | 資訊工程師 |
| ★部門(或產線) | 製程整合部門 | 工業工程部門 | 資訊部門 |
| ★地點(或廠區) | 新竹新豐廠/桃園新屋廠 | 桃園新屋廠 | 桃園新屋廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.產品良率改善與品質問題整合訓練  2.製程異常調查流程學習  3.各量產產品良率改善流程及經驗學習  4.EDA基本使用學習 | 1.產能需求預估訓練  2.直接人力需求估算訓練  3.設備標準產能估算及優化評估訓練  4.物料/零配件編碼及規範管理說明  5.設備及隔間Layout規劃訓練 | 1.組織定位、未來展望及重點專案說明  2.程式開發語言及管理工具訓練  3.企業流程探勘及流程再造分析規劃  4.LineBot及RPA數位工具應用 |
| ★實習期間  (可複選) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) | ☑學期(2023.2~2023.6)  ☑學期(2023.9~2024.1)  □暑期(2023.7~8月) |
| ★所需人數 | 14人 | 2人 | 12人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少：\_40\_\_\_時  (或)每周至少：5天 | 每周至少：\_40\_\_\_時  (或)每周至少：5天 | 每周至少：\_40\_\_\_時  (或)每周至少：5天 |
| 希望校/系 | 工程學科類, 自然科學學科類, 資訊工程相關 | 工業工程相關科系 | 資訊工程相關, 資訊管理相關, 其他數學及電算機科學相關 |
| 英文能力 | □略懂 🗹中等 □精通 | □略懂 🗹中等 □精通 | □略懂 ☑中等 □精通 |
| 其他需要  檢附之資料 | 🗹履歷🗹成績證明 □其他： | 🞎履歷 🞎成績證明 □其他： | □履歷 □成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 🗹期待後續留任 □待評估 | □僅為階段支援 🗹期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ☑期待後續留任 □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | 🞎提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  🗹長期性職缺(不限時) | 🞎提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  🗹長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  □提出申請後3-6個月  ☑長期性職缺(不限時) |